

Kixx Immersion Fluid S

키스 이머션 플루이드 에스

데이터센터 서버 전용 액침냉각유



제품설명

Kixx Immersion Fluid S는 데이터센터 분야 최신 냉각 방식인 액침냉각(Immersion Cooling) 전용으로 개발된 제품으로, 최신 합성기술 기반 소재와 최첨단 첨가제를 이용하여 데이터센터의 냉각 에너지 효율을 개선하고 서버 하드웨어를 안정적으로 보호할 수 있는 액침냉각유 제품입니다.

액침냉각(Immersion Cooling)은 서버, 배터리 등의 전자제품을 비전도성 액체에 직접 담구어 냉각시키는 기술로 기존 공기 냉각(Air Cooling) 방식 대비 에너지 효율이 높아 데이터센터, EV(Electric Vehicle) 배터리, ESS(Energy Storage System) 배터리, 전기차용 급속 충전기 분야에서 적용 가능성이 높은 기술입니다.

또한 액침냉각(Immersion Cooling)은 기존 공기 냉각(Air Cooling) 방식 대비 서버 고장의 주요 원인 인 발열, 먼지, 진동 영향을 최소화하기 때문에 하드웨어 사용 수명 향상을 기대할 수 있습니다.

제품특징

- 서버 적용성 평가를 통해 검증된 제품**
실제 데이터센터용 서버를 액침냉각 환경에 적용하여 서버 정상 가동, 열관리 성능 및 에너지 효율화를 검증
- 에너지 효율 향상을 위한 설계된 유체(Fluid)**
냉각 에너지 효율 향상 및 장비 안전성 향상을 위한 유체 설계(Fluid Design)
- 인체, 환경 친화적 소재 적용**
NSF Food Grade, 생분해성 물성을 보유한 소재를 적용하여 인체 및 환경에 미치는 영향 최소화

제품용도

- 데이터센터 서버용 Immersion Cooling System
- 그 외 Immersion Cooling 기술이 적용 가능한 분야

대표성상

Test Items	Test Method	Kixx Immersion Fluid S
Appearance	ASTM D4176	Bright & Clear
ASTM Color	ASTM D1500	L0.5
Auto-Ignition Point	ASTM D659	> 320 °C
Flash Point	ASTM D92	> 150 °C
Pour point	ASTM D6749	<-60 °C
Density @15°C	ASTM D4052	796 g/l
Viscosity (40°C)	ASTM D445	5 cSt
Water Content	ASTM D6304	≤40 ppm
Acidity	ASTM D664	≤0.01 mg KOH/g
Thermal Conductivity	ASTM D7896	0.13 W/m · K
Specific Heat	ASTM D7896	2.29 kJ/Kg · K
Breakdown Voltage	IEC 60156	> 30 KV
Dielectric Dissipation Factor	IEC 60247	< 0.005
Volume Resistivity	IEC 60247	> 1.0 X10 ³ GΩ.m

* 상기 대표성상은 평균 시험치로 제품성능에 이상이 없는 범위내에서 실제 제품의 수치와 다소의 차이가 있을 수 있습니다. (2023.10)